

第88回マイクロ接合研究委員会 プログラム

日 時：平成 20 年 9 月 5 日(金) 10:30～16:30

場 所：自動車会館（東京 市ヶ谷）

	時 間	題 目	講 演 者
平成 20 年 9 月 5 日 (金)	司 会 阪元 智朗 (オムロン株)		
	10:30～11:15	『錫の固相接合界面特性に及ぼす表面性状の影響』	群馬大学大学院 ○小山真司 大阪大学接合科学研究所 池内建二
	11:15～12:00	『パッケージ基板に適応した 無電解Ni-P/Auめっき技術』	奥野製薬工業株 ○田邊靖博、下地輝明 松浪卓史
	12:00～13:00	昼 食 休 憩	
	13:00～13:10	委 員 会 議 事	
	司 会 荻谷 義治 (芝浦工業大学)		
	13:10～13:55	『鉛フリーはんだの微小サンプルによる力学特性評価と EBSP(電子後方散乱回折像)による塑性ひずみの評価』	株コベルコ科研 ○中本久志、横幕俊典 与田利花、原田晋吾
	13:55～14:40	『マイクロインデントーによる微小領域の力学特性評価 - 押込みクリープの構成式の決定と応用 - 』	日本大学工学研究所 ○藤原雅美
	14:40～15:00	休 憩	
	司 会 石塚 直美 (日本電気株)		
15:00～15:45	『実装工程をシミュレーションしたぬれ性の解析・評価技術』	株マルコム ○稲毛 剛	
15:45～16:30	『微小はんだ接合体の低サイクル 疲労寿命および負荷波形の影響』	芝浦工業大学大学院(学生) ○ 神田喜彦 芝浦工業大学 荻谷義治	

※プログラムは都合により若干変更になることがありますので、予めご了承下さい。